

定量供給はんだ材料

Measured Supply Solder Material

必要なところに局所追加、必要なところを局所加熱

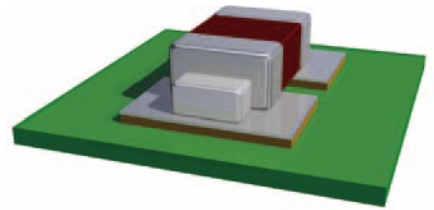
Localized supplementation and localized heating where needed

EC SOLDER[®] PREFORM

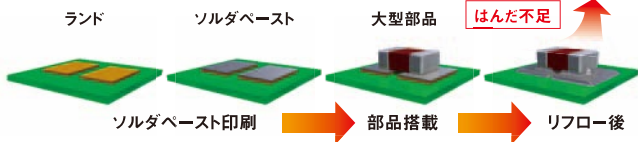
自動搭載用はんだペレット チップソルダー

特長

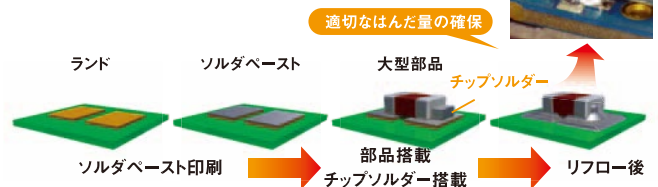
- チップ部品実装の要領手順で使用（搭載）可能。
- ペーストと同時加熱、追加はんだ工程が不要。
- 追加はんだ量の定量化管理が容易。
- 高い接合強度が求められる部分に最適。



□ 導入前 (大きな部品のはんだ量不足)



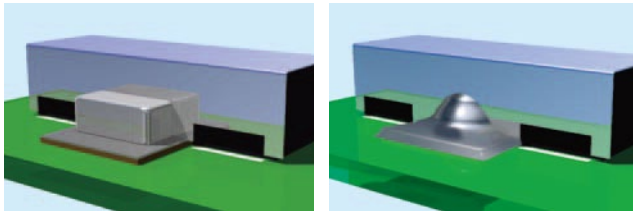
□ 導入後 (チップソルダー実装)



製品仕様

□ 使用例

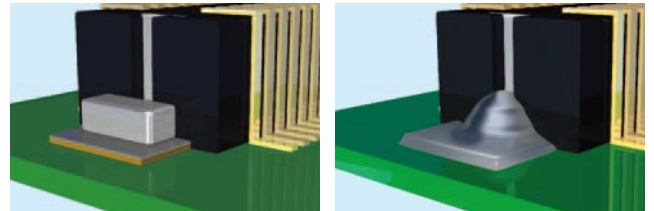
シールドケース



溶融前

溶融後

コネクタ



溶融前

溶融後

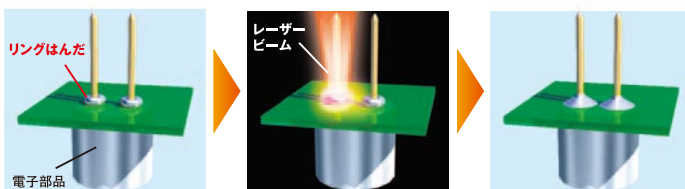
EC SOLDER[®] PREFORM

リングはんだ

特長

- 各種組成・線径・形状、やにの有無などの要求に対応可能。
- 様々な加熱方法で、はんだ付けが可能。(レーザービーム、コテ、ハロゲンヒーター、リフロー炉など)
- リード付部品のはんだ付けに最適。

□ 製品使用事例



□ 製品使用例写真

